

# 合肥晶合集成电路股份有限公司

## 关于 2025 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 2025 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
- 公司 2025 年度利润分配方案是基于公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营模式，并结合公司未来研发投入需求、产能扩充等长期战略发展规划，以及全体股东长远利益的综合考虑。
- 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 一、利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 70,420.44 万元，2025 年末合并报表中未分配利润为 144,226.68 万元，公司母公司报表中期末未分配利润为 176,472.45 万元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》等相关规定，综合考虑公司所处行业情况和特点、公司发展阶段、自身经营模式、未来研发投入需求以及产能扩充等长期战略规划，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨

论，拟定公司 2025 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

## （二）是否可能触及其他风险警示

公司不存在可能触及其他风险警示情形的情况，相关数据及指标如下表：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	194,404,665.70	/
回购注销总额（元）	0	0	/
归属于上市公司股东的净利润（元）	704,204,446.26	532,840,611.25	/
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,764,724,521.72		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	194,404,665.70		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 3000 万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	618,522,528.76		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	194,404,665.70		
现金分红比例（%）	31.43		
现金分红比例是否低于 30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	2,737,375,384.44		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	20,134,701,621.50		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	13.60		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在 15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：公司于 2023 年 5 月 5 日在上海证券交易所科创板上市，根据《科创板股票上市规则》规定，公司上市不满三个完整会计年度的，最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度，故上表中“最近三个会计年度”系指 2024 年度、2025 年度。

## 二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

公司 2025 年度拟不进行利润分配，是基于公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营模式，并结合公司未来研发投入需求、产能扩充等长期战略发展规划，以及全体股东长远利益的综合考虑，具体原因分项说明如下：

#### **（一）公司所处行业情况及特点**

公司主要从事 12 英寸晶圆代工业务。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。公司所处的晶圆代工行业属于技术、资本、人才密集型行业，需要大量的资本支出和人才投入，具有较高的进入壁垒。

#### **（二）公司盈利水平及资金需求**

2025 年度，公司实现营业收入 1,088,544.93 万元，较上年同期增长 17.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 70,420.44 万元，较上年同期增长 32.16%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,203.82 万元，较上年同期下降 48.77%。

2026 年，公司将基于产能扩充、业务布局和研发计划，进一步吸纳并培养优秀高科技人才，加大重要研发项目的投入，同时拓展国内外客户并加深合作粘性，为经营业绩长期稳定增长和全体股东的投资价值回报提供保障。为此，公司需要资金保障来实现现阶段和长远发展目标。

#### **（三）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况**

公司 2025 年度未分配利润将累计滚存至下一年度，主要用于公司设备购置、产能扩充、经营周转、研发投入、人才引进等方面。公司将持续提升综合竞争力，切实推动公司长期战略发展规划的落地实施，持续增强公司的盈利能力，更好地维护公司及全体股东的长远利益。

### **三、公司履行的决策程序**

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。董事会认为公司 2025 年度拟不进行利润分配，充分考虑了行业发展情况、公司发展阶段、研发投入及经营发展的资金需求，符合相关法律法规以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此董事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交股东会审议。

#### 四、相关风险提示

公司本次利润分配方案充分考虑了行业情况、公司发展阶段、研发投入及生产经营发展的资金需求等因素，不会对公司的现金流产生重大影响，亦不会影响公司的正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026年3月27日